

檔 號：
保存年限：

台灣發明商品促進協會 函

地址：105台北市松山區八德路二段400號7樓
承辦人：賴淑玲
電話：02-8772-3898#19
Email：wiipal68@wiipa.org.tw

受文者：基隆市立銘傳國民中學

發文日期：中華民國113年6月11日
發文字號：台發學字第1130061107號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (1130061107_Attach1.pdf、1130061107_Attach2.docx)

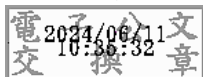
主旨：敬邀 貴校師生參加「2024第11屆高雄國際發明暨設計展」。

說明：

- 一、台灣發明商品促進協會，深耕台灣發明32載，集結專業團隊及掌控全球脈動，擅長整合跨國資源，有效提升參展效益。
- 二、「2024第11屆高雄國際發明暨設計展」將於113年12月5日至12月7日在高雄展覽館舉辦，敬邀 貴校師生參賽，請惠予公告並鼓勵相關人員踴躍參加。
- 三、早鳥報名加碼專案，補助「曼谷國際發明展」參展費。
- 四、即日起報名至113年10月15日止，洽詢專線(02)8772-3898分機19賴小姐或email至wiipal68@wiipa.org.tw。

正本：基隆市立明德國民中學、基隆市立銘傳國民中學、基隆市立中正國民中學、基隆市立南榮國民中學、基隆市立成功國民中學、基隆市立正濱國民中學、基隆市立建德國民中學、基隆市立百福國民中學、基隆市立碇內國民中學、基隆市立武崙國民中學

副本：



施養隆 會長

裝

訂



線

